

Kokillen aus einem auseinandernehmbaren gußeisernen Rahmen. Zur Erzielung einer glatten, porenfreien Unterfläche muß stets, falls die Bodenplatte nicht bereits aus Kupfer besteht, zunächst eine solche gegossen werden, auf die nach ihrer Erstarrung erst der eigentliche Guß erfolgt. Für kleine Platten wird auch wohl die Kokille höher gemacht, so daß man darin mehrere Platten übereinander gießen kann; die untere bildet dann jeweils die Bodenplatte für die nächstfolgende. Um beim Eingießen mittels Kübels eine große offene Oberfläche zu gewährleisten, wird dieser ständig hin und her bewegt oder ein beweglicher Verteilungslöffel dazwischengeschaltet.

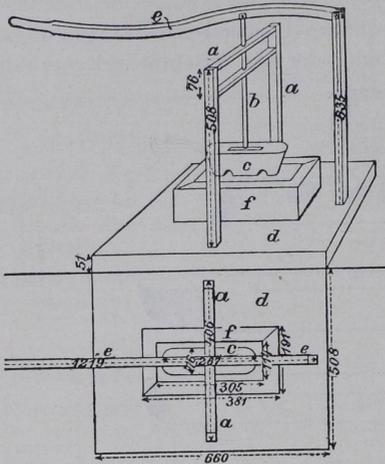


Fig. 135. Vorrichtung zum Gießen von Blöckchenformen aus Kupfer. Ansicht von oben und von der Seite. Die auf der massiven Kupferplatte *d* liegende geteilte Form *f* wird voll Kupfer gegossen und die Patrise *c* mittels des Hebels *e* eingedrückt. (Aus Schnabel, Hdb. Bd. I.)

Für große Walzplatten und Zylinder (die stehend gegossen werden) verwendet man hier gerne den steigenden Guß; die Bodenplatte, auf der unter Umständen mehrere Kokillen stehen, besteht dann natürlich ebenfalls aus Kupfer.

Für die die größten Qualitätsansprüche bedingenden Drahtbarren (wire bars), d. h. für die Barren, aus denen elektrischer Leitungsdraht hergestellt wird, benutzt man fast stets kupferne, ähnlich wie die für Blöckchen selbst hergestellte Formen, wenigstens soweit es sich um Material handelt, das nicht im

eigenen Betrieb weiterverarbeitet wird; das Gießen erfolgt mit der Hand oder der Maschine, selten mittels Kübels. Die Barren sind sehr lang und schmal, an beiden Enden zugespitzt, von verschiedenem Querschnitt und wechselnder Länge (Fig. 133).

2. Schlacke.

Die erste Schlacke, die beim Einschmelzen fällt und verhältnismäßig Cu-arm und gut geschmolzen ist, wandert im allgemeinen in die Steinarbeit im Schacht- oder Flammofen. Dagegen ist die meist schlecht geschmolzene, oft gekrätzartige zweite oder eigentliche „Raffinadschlacke“ derartig Cu-reich (bis über 50% Cu), daß es sich lohnt, sie direkt auf Schwarzkupfer zu verarbeiten. Näheres hierüber s. S. 292.

3. Glühspan, Hammerschlag.

Er wird von Zeit zu Zeit aus den zum Ablätzen des Kupfers dienenden Bassins herausgeholt, getrocknet und dient, da er in der Hauptsache aus reinem CuO besteht, als wertvoller, die Oxydation unterstützender und beschleunigender Zuschlag beim Raffinieren, wobei ein großer Teil des Cu-Inhaltes in das Metall, der Rest in die Schlacke geht.